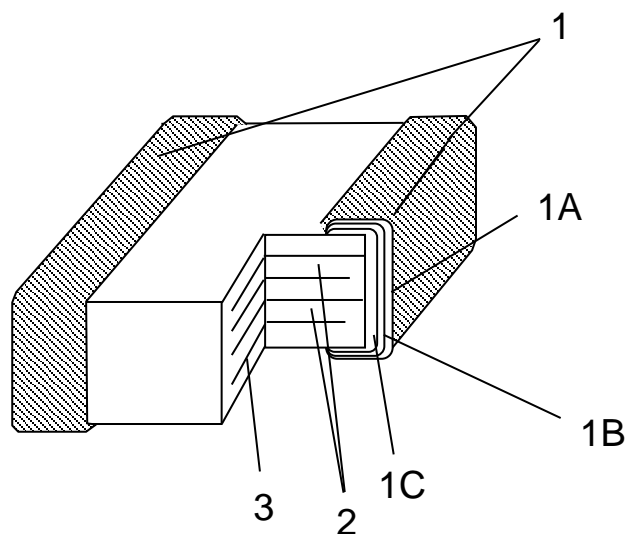


低 ESL チップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表
 Structure and Material of Low ESL Chip Multilayer Ceramic Capacitor

<LLL/LLC Series>



No.	名称(Name)	材料(Material)
1	外部電極 (Termination)	1A すずめっき(Sn plated)
		1B ニッケルめっき(Ni plated)
		1C 銅(Cu)
2	誘電体素子(Dielectric layer)	チタン酸バリウム(BaTiO ₃)
3	内部電極(Inner electrode)	ニッケル(Ni)